

第 28 回宇宙用部品連絡会アジェンダ案

日時： 平成 25 年 1 月 31 日（木） 14 : 00～16 : 30
場所： 東京：東京事務所 4F 401、402 及び 403 会議室
筑波：総合開発推進棟 2F 中会議室 b1
（東京⇄筑波 テレビ会議設定）

1. 開会の挨拶
 2. 部品ユーザからの情報 (14 : 00－14 : 20 20 分)
 3. 部品メーカーからの報告 (14 : 20－14 : 40 20 分)
 - 3.1 チップ形ヒューズの開発 (株立山科学デバイステクノロジー)
 - 3.2 マイクロミニチュアコネクタの認定スケジュールについて (株アイティティキャノン)
 4. 部品生産のスケジュールに関して (14 : 40－15 : 05 25 分)
 - 4.1 積層セラミックコンデンサ (株福井村田製作所)
 - 4.2 状況報告
 - ・チップ形タンタル固体電解コンデンサ (松尾電機株)
 - ・パワーMOSFET (富士電機株)
 5. QPL/QML 部品認定状況、その他活動報告 (15 : 05－15 : 20 15 分)
 - 5.1 共通部品等の認定状況
 - 5.2 QTS/ADS の改定状況
 - 5.3 認定部品の変更管理状況
 - ◆休憩◆ (15 : 20－15 : 35 15 分)
 6. 海外情報 (15 : 35－16 : 15 40 分)
 - 6.1 海外宇宙機関 関連情報
 - 6.2 G12/11 報告
 - 6.3 ISTFA 報告
 7. その他 (16 : 15－16 : 30 15 分)
 - 7.1 半導体デバイスの放射線勉強会の紹介 (HIREC株)
 - 7.2 宇宙用1MG G/Aのウエハー製造 (HIREC株)
 - 7.3 今年度の行事及び予定
 8. 閉会の挨拶
- ※意見交換会 (17 : 45 ～)
場所等については別途連絡。